PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-085273

(43)Date of publication of application: 27.05.1982

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number : 55-161665

(22)Date of filing:

: 55~161665 17.11.1980 (71)Applicant :

TOSHIBA CORP

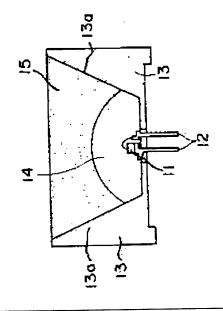
(72)Inventor:

FUJIMURA NORIO

(54) PHOTO-SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease luminous loss, and to uniformalize the brightness of a display surface by forming a resin layer in a reflector by resin for shaping the display surface and resin having excellent transmittance and forming the boundary suface in a curved surface shape. CONSTITUTION: A light-emitting element 11 is connected electrically to a frame 12, and the transmitting resin 14 having excellent light transmittance is solidified spherically and the display surface is formed by the scattering resin 15 having scattering power in the reflector 13. Accordingly, the display surface having excellent uniformity is obtained because the resin is spherical. And luminous loss is decreased because there is the resin 15 between the element 11 and the display surface.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(1) 日本国特許庁 (JP)

1. 特許出願公開

沙公開特許公報(A)

昭57—85273

5î Înt. Cl.³ H 01 L 33.00 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 43公開 昭和57年(1982)5月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分光半導体装置

乳特 願 昭55-161665

谷出 ・ 願 昭55(1980)11月17日

饱発 明 者 藤村則夫

川崎市幸区堀川町72番地東京芝 浦電気株式会社堀川町工場内

作出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

作代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 網 14

1. 発明の名称

光半導体装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体発光素子と、この半導体発光素子を配散した金銭フレームと、外題器を構成し、前配半導体発光素子からの発光を設示面に反射させる反射面を有する反射体と、この反射体内部に充てんされ、脈折率の異なる複数の樹脂で形成された樹脂層とを具備したことを特徴とする光半導体装置。

(2) 前配複数の樹脂の境界面を曲面状とした ことを特徴とする特許翻求の範囲第1項記載の 光半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は光半導体装置に係り、特に発光効 客を改良した半導体発光設置に関する。

従来、平面発光を得るための単導体発光報賦 (以下、発光装置と略称する)の構造としては、 次に示すA, Bの2方式が主催となっている。

まず、Aの方式は、第1図(a), (b)に示すように、 発光案子』を導電性金銭フレーム 3 に電気的に 接続し、更に周囲を例えばエポキン樹脂3で便 化した所謂 LED (Light Emitting Diode)ランプ を、外囲器を構成しLED ランプからの側面への放 射光を反射する反射面を有する反射体(の中に 做込み、更にとの反射体1の上面に、表示面を 形成しLEDランナからの発光を均一に拡散する 拡散板 5 を接着するととで、平面発光表示を行 りものである。との方式は、発光楽子1が凸レ ンメをもった LED ランプに変換されているため 発光器子1からの発光の配光特性を変えること ができ、均一性の良い犬沢面が得られる利点を 有する.しかしながら、反射体 4 と拡散板 5 の 間定方式に手間がかかり、また強光米子1から 投水面に至るまでに樹脂 3 と空気中と拡散板 5 そいうように異たった脂が多く、発光の損失が 大きいという欠点を有する。

一方、B の方式は、第2 図(a)。 (b) に示すように、発光米子 6 をフレーム 1 に 電気的に扱続し、こ

この発明は上記実情に鑑みてなされたもので、その目的は、B 方式の発光装置において、反射体内部の側脂層を、炭なる流過性の優れた側脂質をの関抗率の異なる流過性の優れた側脂とので形成し、かつその境界面を曲順状とするとのでより、発光接機と同様の均一性の良い状況をしたの発光装機と同様の均一性の良い状況をしたもる。

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を 説明する。第3回はその断慮図を示すもので、

3

この状態で、一定飲品性問題15を硬化させるの次に第4例(のに示すように透過性の良い例をはエポキン問胎の適当性例由14を注入し、フレーム12に接続された発光ボ子11を入れた後、透過性倒脂14を硬化させることで製造な終了する。なか、上記飲品性問胎15のはい上がりの形状は、例射15の形状によりコントロールできるものである。

以上のようにとの発明によれば、反射体内部の樹脂層を、此が面形成用の樹脂ととの側脂と成折率の異なる透過性の優れた側脂とで形成しかつその境界調を曲前状とするようにしたので、発光損失が少なく、投示面の明るさが均一である光半導体後間を提供できる。

4.図面の簡単な説明

第1回(a)(b)は従来の発光投配(A 方式)の構成を示するので、(a)は分解斜視図、(b)は断面図、第2回(a)(b)は同じく従来の発光投膛(B 方式)の構成を示するので、(a)は分解鉄視図、(b)は断

指開船57- 85273(2)

第光米子11をフレーム12に世気的に接続し、 これを反射体13の内部で、まず遊過性に使れ た透過性側面14を球面状に固め、更に散乱性 をもった散乱性側面15で表示面を形成したも のでもる。

すなわち、との発光装置においては、透過性 例期」 4 が球崩状であるため、前記 A 方式の LED ランプ阿根の効果を強し、均一性に優れた 製示前を得ることができる。さらに、発光集子 1 1 と沢示阗との間は、渡過性側距 1 4 と、こ の側距 1 4 と組折率の異なる散乱性側距 1 5 の みて形成されているため、発光の損失が少ない。

次に、上記品光整體の製造方法の一例を示す。 まず、部4図(a)に示すように、反射体13を逆 さにして投水部を粘着テープ16等で密着させ、 散品別(例をはアルミナ)を含んだエポキシ側 脂の散乱性側脂15を第4図(b)に示すように反 射体13の嫉部(図では上部)の第ロ17から 代入する。この際、反射体13の調面により装 面級力で散乱性側脂15の周級部がはい上がる。

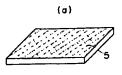
4

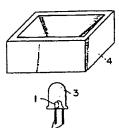
面図、斜3図はとの発明の一次始例に係る発光 装置の構成を示す断面図、第4図(a)。(b)。(c)は 上記発光装置の製造方法を示す図である。

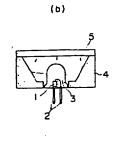
11…発光案子、12…フレーム、13…反射体、13c…反射価、14…透過性側面、15…仮見性側面、16…粘管テープ。

们颇人代理人 介理士 鉛 江 武 彦

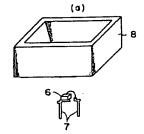
a≽ 1 n⊽7

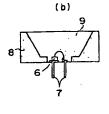


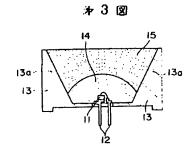




*** 2 図**







(a) 17 13 13 13 15 16

